

A64

l i c h e e 使用手册

Confidential

文档履历

版本号	日期	制/修订人	制/修订记录
V1.0	2015-06-10		初始版本

Confidential

目录

A64	1
1. 简介	4
2. 目录结构	4
2.1. brandy	4
2.2. buildroot	5
2.3. linux-3.10	5
2.4. tools	6
3. 编译系统	7
3.1. 使用说明	7
3.2. 二次开发	7
3.2.1. 指定配置文件	7
3.2.2. 添加系统平台	8
3.2.3. 打包脚本说明	8
4. Lichee 定制	8
4.1. 根文件系统定制	8
4.2. 集成软件包	8
4.2.1. 可执行文件	8
5. 固件定制	9
5.1. 分区属性	9
5.2. 规划分区	9
6. Declaration	11

1. 简介

本文档用于介绍 A64 芯片的 Linux BSP 的目录结构，固件定制和 Lichee 定制。

2. 目录结构

```
├── buildroot
├── build.sh
├── linux-3.10
├── README
└── tools
```

2.1. brandy

存放 boot0 和 u-boot 源码，其目录结构为

```
├── build.sh
├── arm-trusted-firmware-1.0
├── armv8_toolchain
├── extern-libs
├── gcc-linaro
├── pack_tools
├── toolchain
└── u-boot-2014.07
```

brandy 源码一共包含以下几个部分：用于烧录的 fes1，用于启动的 boot0，用于烧写和启动的 uboot，另外还包括支持安全控制和 PSCI 的 ATF(arm-trusted-firmware)，其中 fes1 和 boot0 代码生成的 bin 文件体积必须控制在 24K 以内。编译命令(没有修改该部分源码，就不需要编译 brandy)：

```
$ cd brandy
```

方法 1：一次性编译 boot 需要的所有文件

```
$. /build.sh -p sun50iw1p1(生成 boot0、uboot、fes、atf)
```

方法 2：单独编译 boot 各部分 bin 文件

```
$ cd brandy/u-boot-2014.07
```

```
$ make distclean --清理临时文件
```

```
$ make sun50iw1p1_config --配置 sun50 平台，只需要执行一次，如果执行了 make
distclean，则需要再运行一次
```

```
$ make -j8 --生成 uboot
```

```
$ make boot0 --生成 boot0
```

```
$ make fes --生成 fes
```

```
$ cd brandy/arm-trusted-firmware-1.0
$ make --生成 atf
```

以上编译命令要在配置平台后才能运行，生成的 bin 文件会自动拷贝到相应的目录。

gcc-linaro: u-boot 和 boot0 交叉编译工具链。

toolchain: arm-trusted-firmware 交叉编译工具链

u-boot-2014.07: u-boot、boot0 和 fes 源码，包括启动引导、量产烧写的代码。

arm-trusted-firmware-1.0: 支持安全控制和 PSCI 的源码

Pack_tools: 打包时使用的打包工具的源码

2.2. buildroot

buildroot 的主要作用是

- 管理编译脚本和交叉编译工具链
- 定制开发 DragonBoard 测试用例
- 制作 Linux 固件的根文件系统，
可以包含 strace, directfb, oprofile 等非常丰富的应用软件和测试软件。

目录结构如下

```
├── board
├── boot
├── CHANGES
├── Config.in
├── configs
├── COPYING
├── dl
├── docs
├── external-packages
├── fs
├── linux
├── Makefile
├── package
├── README
├── scripts
├── target
└── toolchain
```

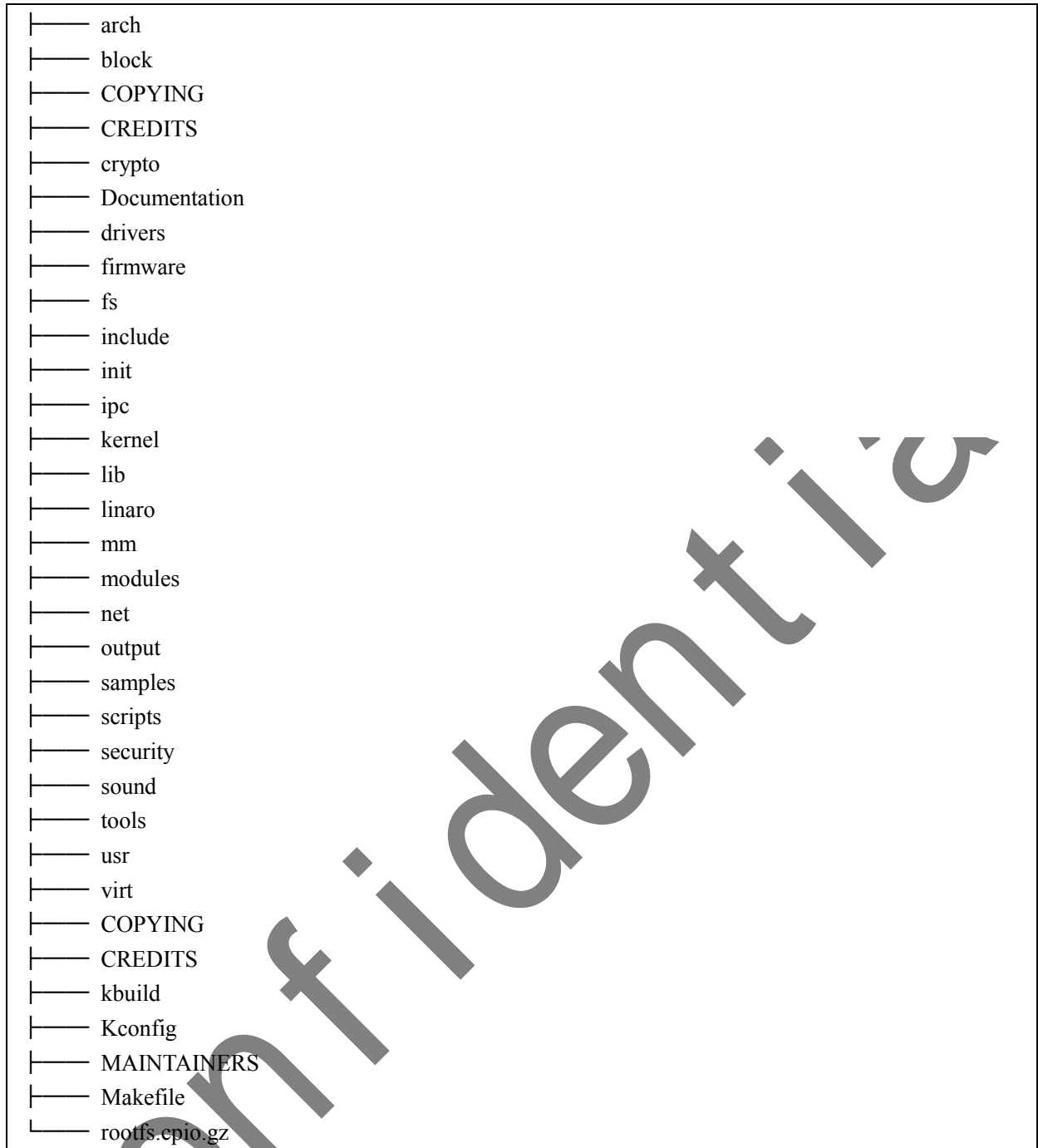
scripts: Lichee 编译脚本，主要包含 mkcmd.sh, mkcommon.sh, mkrule 和 mksetup.sh。

target/dragonboard: dragonboard 定制开发根目录。

2.3. linux-3.10

Linux 内核源码目录，结构如下

```
├── android
```



以上目录结构跟标准的 Linux 内核一致，除了 `modules` 目录。`modules` 目录是我们用来存放没有跟内核的 `menuconfig` 集成的外部模块的地方。我们目前放了 `aw_schw`, `gpu` 和 `nand` 这 3 个外部模块，其中 `aw_schw` 是密钥模块：存储 `key`，`gpu` 是 GPU 驱动，`nand` 是 `nand` 驱动。

2.4. tools

目录结构如下



└── tools_win

该目录存放方案系统配置、打包脚本和工具，以及部分平台相关的工具。

用途	位置
方案配置	pack/common/
	pack/chips/sun50iw1p1/configs/
打包脚本和工具	pack/pack
	pack/pctools/
平台相关的工具	tools_win/

3. 编译系统

3.1. 使用说明

参考《A64_Tablet SDK Quick Start Guide》。

3.2. 二次开发

Lichee 编译脚本目前支持编译 buildroot 和 linux 内核，主要包括以下文件，

build.sh

buildroot/scripts/mkcmd.sh

buildroot/scripts/mkcommon.sh

buildroot/scripts/mkrule

buildroot/scripts/mksetup.sh

tools/pack/pack

3.2.1. 指定配置文件

当开发新的平台或者方案时，需要指定 buildroot 和内核的配置文件，修改 buildroot/scripts/mkrule 文件，文件格式如下，

<芯片编号>_<系统平台> <buildroot 配置文件> <内核配置文件>

或者：

<芯片编号>_<系统平台>_<方案> <buildroot 配置文件> <内核配置文件>
--

芯片编号：例如 sun50iw1p1

系统平台：例如 android

方案：例如 t1

buildroot 配置文件：不需要用 xxx 表示

内核配置文件：例如 sun50iw1p1smp_android_defconfig

将新的芯片平台以上信息汇成一行添加到文件中即可。

3.2.2. 添加系统平台

目前默认支持 4 个系统平台，分别是 android, dragonboard, linux, tina。如需添加新的平台，修改 buildroot/scripts/mkcmd.sh 文件的 platforms 数组，例如添加 firefox 平台：

```
platforms=(
"android"
"dragonboard"
"linux"
"tina"
"firefox"
)
```

3.2.3. 打包脚本说明

打包时需要拷贝若干文件到 tools/pack/out 目录，目前脚本对其进行了分类，分别是 tools_file_list, configs_file_list, boot_resource_list 和 boot_file_list，新增文件可以归入其中一类或者创建新类。

目前打包脚本分为 4 个阶段，分别是 do_prepare, do_common, do_pack_<platform>和 do_finish。

do_prepare: 完成文件拷贝和预处理动作。

do_common: 完成所有系统平台通用的文件解析，分区打包。

do_pack_<platform>: 完成当前系统平台特有的工作。

do_finish: 完成打包。

4. Lichee 定制

本章节主要介绍如何定制 Linux 固件根文件系统。

4.1. 根文件系统定制

Sdk1.0 中 linux-3.10 中的根文件系统为 64bit,但是发布的源码包为 32bit 的 buildroot 源码包(供 dragonboard 使用),暂时不支持自定义 linux 固件根文件系统。

4.2. 集成软件包

4.2.1. 可执行文件

直接添加到 lichee\out\linux\common\buildroot\output\target 中（前提是已经完全编译过一次），指令直接添加到 bin、sbin 或者 usr 下的 bin、sbin 中，其他可执行文件可以添加在希望指定的任意文件夹下。

5. 固件定制

固件主要包括方案配置文件、启动引导文件、烧写引导文件和分区镜像等。其中分区镜像由方案的 `sys_partition.fex` 文件配置，其余由 `image.cfg` 文件配置。两个文件的默认存放路径如下：

	sys_partition.fex 文件	image.cfg 文件
Android	tools/pack/chips/sun50iw1p1/xxx/	tools/pack/chips/sun50iw1p1/default/image.cfg
DragonBoard	tools/pack/chips/sun50iw1p1/default/	tools/pack/chips/sun50iw1p1/default/image.cfg
Linux	tools/pack/chips/sun50iw1p1/default/	tools/pack/common/imagecfg/ image_linux.cfg

如需使用自定义的 `sys_partition.fex` 和 `image.cfg` 文件，只需在方案的目录下添加文件名相同的文件即可。

下面主要介绍分区属性和如何规划分区。

5.1. 分区属性

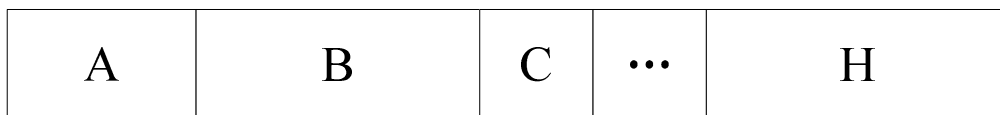
分区定义示例：

[partition]	
name	= system
size	= 1572864
downloadfile	= "system.fex"
user_type	= 0x8000

属性	描述
name	分区名称，最大 12 个字符
size	分区大小，单位是扇区（512Bytes）；Nand 方案为了安全和效率考虑，分区大小最好保证为 16M 字节的整数倍。
downloadfile	分区镜像文件
keydata	标志是否为私有数据分区，1 表示是，0 表示否
encrypt	采用加密方式烧录，将提供数据加密，但损失烧录速度，1 表示采用默认加密方式，?表示私有用法
verify	量产完成后校验是否正确，1 表示校验，0 表示不做校验

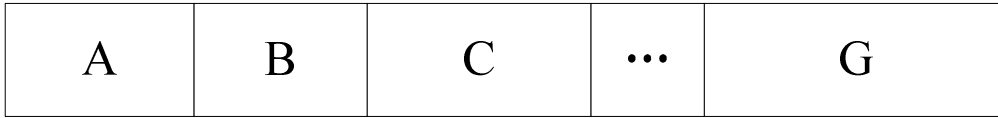
5.2. 规划分区

分区，是指存储设备(通常是 Nand 或者 eMMC)上，根据逻辑关系划分的空间。习惯上，分区的编号从 0 开始，代表第一个分区，1 代表第二个分区，以此类推。这项规则类似于 PC 上的硬盘分区，如下图所示。



上图存储设备上一共有 A-H 共 8 个分区，其中，分区 A 的起始位置从存储设备的头部开始，是第一个分区，分区 H 占用了尾部，是最后一个分区。

规划分区，是指在固件包中指明存储设备上的分区个数，并由用户自己定义分区属性。当烧写固件包后，存储设备上就会存在这样由用户定义的分区。用户可以通过下图的方式规划分区。



通过上图可以看出，B 分区的容量减小，C 分区容量增大，同时增加了 G 分区。

在 Lichee 中，最后一个分区的大小无需指定，是存储设备的容量减去前面分区大小的总和，该分区通常称为 UDISK 分区，在 Android 中用作 sdcard 分区（单用户）或者 data 分区（多用户）。因此，添加的分区必须在 UDISK 分区前面。例如，下面是 Android 系统标准的分区划分，

分区名称	大小	说明
bootloader	32M	存放启动 logo 等资源文件
env	16M	存放 u-boot 引导参数
boot	16M	存放 kernel 和 ramdisk
system	1.5G	
data	2G	
misc	16M	
recovery	32M	
cache	768M	
metadata	16M	存放全盘加密 KEY
private	16M	存放 SN 号
UDISK		sdcard 分区

为了使用固件修改工具的克隆功能，需要添加一个 databk 目录，大小为 256M，添加后新的分区划分如下，

分区名称	大小	说明
bootloader	16M	存放启动 logo 等资源文件
env	16M	存放 u-boot 引导参数
boot	16M	存放 kernel 和 ramdisk
system	1.5G	
data	2G	
misc	16M	
recovery	32M	
cache	640M	
metadata	16M	存放全盘加密 KEY
private	16M	存放 SN 号
databk	256M	
UDISK		sdcard 分区

具体操作是修改方案目录下的 sys_partition.fex 文件，在 UDISK 分区前加入

```
[partition]
name      = databk
size      = 524288
```

ro	= 0
user_type	= 0x8000

6. Declaration

This document is the original work and copyrighted property of Allwinner Technology (“Allwinner”). Reproduction in whole or in part must obtain the written approval of Allwinner and give clear acknowledgement to the copyright owner.

The information furnished by Allwinner is believed to be accurate and reliable. Allwinner reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice. Allwinner does not assume any responsibility and liability for its use. Nor for any infringements of patents or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Allwinner. This datasheet neither states nor implies warranty of any kind, including fitness for any particular application.

Confidential